

苏州天脉导热科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	第一场 10:30-11:30 山西证券、海创基金、中欧基金、远海基金、方以投资共 8 人 第二场 15:00-16:00 广发证券、泓澄投资、东方证券、宏道投资、鑫元基金、广发证券、弘毅远方基金、和谐汇一共 8 人
时间	2024 年 11 月 21 日 10:30-11:30、15:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、财务总监兼董事会秘书：龚才林 证券事务专员：尹静
投资者关系活动主要内容介绍	公司与投资者交流情况： 1、问：请简要概述公司主营业务、主要产品的演变情况？ 答：公司成立于 2007 年，成立之初，公司主要产品为导热界面材料，由于其核心技术的掌握依赖于长期的研发投入和技术沉淀，在中高端产品领域技术壁垒较高，市场长期由欧美及日本厂商所垄断。公司自成立以来，在该领域不断投入技术力量进行配方研发和工艺改进，经过十余年的持续发展，导热界面材料已发展成为公司的优势产品。公司成功开发的高导热、低挥发、低出油导热硅胶片等系列产品大量应用于消费电子、安防监控、汽车电子、通信设备等中高端产品市场。 2010 年起，以智能手机、平板电脑为代表的消费电子产品迅猛发

展，伴随产品轻薄化、小型化发展所带来的散热需求的增加，消费电子领域在传统导热界面基础上大量应用石墨散热材料，公司于 2012 年自主开发人工合成石墨材料并顺利推出市场。

公司分别自 2014 年、2017 年着手对热管、均温板技术进行研发储备，该阶段由于市场需求尚不明朗，产品量产难度较高，行业内鲜有涉足者，但公司基于对电子散热行业趋势的前瞻性预判，坚持在相关领域进行创新投入与技术积累，储备了大量工艺技术、人才与市场资源。

随着消费电子产品不断向高性能化、多功能化、薄型化趋势发展，以智能手机、笔记本电脑、智能投影仪为代表的消费电子产品内部器件发热量及散热需求显著提升，热管、均温板因其优异的导热性能，被越来越多的消费电子品牌厂商所采用，渗透率不断提升。公司凭借在热管、均温板领域多年的积累，以及优异的产品性能和量产能力，在较短的时间内，快速通过了三星、OPPO、vivo、华为、荣耀、摩托罗拉、魅族、极米、罗技等品牌客户的产品认证，进入其供应链体系，实现规模化量产出货。

2、问：请简要介绍下，在智能手机领域散热产品的应用情况？

答：在智能手机领域，根据散热场景热源功耗、散热要求、空间结构等特点，各类散热产品会被单独或搭配组合使用，传统 4G 手机通常采用“导热界面材料+石墨膜”组合作为散热方案，在 5G 手机、中高性能 4G 手机等领域，工作功耗及散热要求相对更高，通常采用“导热界面材料+石墨膜+热管/均温板”组合或“导热界面材料+热管/均温板”组合作为散热方案。

3、问：请问公司在热管、均温板领域主要有哪些竞争厂商，公司是如何实现在消费电子领域的快速渗透？

答：在热管和均温板领域，公司的主要竞争对手包括尼得科超众、双鸿科技、奇鋆科技、深圳垒石、瑞声科技等。

热管、均温板技术要求较高，批量化生产需要长期的工艺技术和生

	<p>产经验的积累。公司是行业内较早进行热管和均温板产品研发和实现规模化量产的企业之一，凭借在该领域的布局优势，公司产品在较短的时间内通过了三星、OPPO、vivo、华为、荣耀、摩托罗拉等品牌客户的认证，实现规模化供货。近年来，公司通过持续的工艺改进和生产自动化投入，不断提升产品生产效率、缩短交付周期、降低生产成本，使得相关产品市场竞争力不断提升，并推动了热管、均温板产品在消费电子领域的快速渗透。</p> <p>4、问：公司目前主要产品的主要原材料分别有哪些？</p> <p>答：公司导热界面材料的主要原材料包括导热粉料、硅油、胶膜等；石墨膜的主要原材料包括聚酰亚胺膜、胶膜等；热管和均温板的原材料主要是蚀刻件、铜管、不锈钢原材、铜复合材、铜网等。</p> <p>5、问：公司IPO募集资金投资项目的情况？</p> <p>答：公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，具体投资于散热产品生产基地建设项目、新建研发中心项目以及补充流动资金。其中，散热产品生产基地建设项目将新增 1,000 吨导热界面材料、1,200 万套散热模组和 6,000 万只均温板（VC）的生产能力，从而满足下游消费电子、汽车电子、安防监控、通信设备等领域不断增长的市场需求，进一步提升公司在导热散热领域的行业地位。</p> <p>6、问：请问公司目前有没有实施股权激励的计划或安排？</p> <p>答：公司在上市前已向公司高级管理人员及核心员工实施了股权激励，并且公司高级管理人员及核心员工也参与了公司首次公开发行股票的战略配售。公司将综合考虑经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，在未来适宜时机实施股权激励计划，完善公司的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>

附件清单（如有）	无
日期	2024 年 11 月 21 日